



2022

iReport

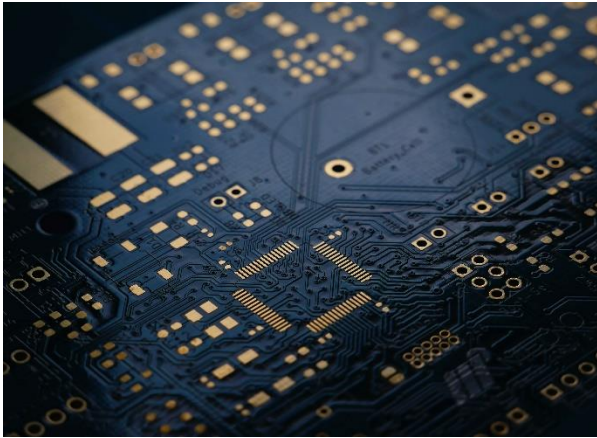
獨家供應記憶體測試與修復解決方案並提供客製化設計服務的公司。



| Istart-Tek

擁有創新獨特且具有專利的記憶體測試與累加式記憶體修復的核心技術，並提供即時性的技術支援服務。透過緊密合作，供應完整的解決方案，使客戶建構最佳化的記憶體測試與修復方式。

► 技術文件 | Technical documents



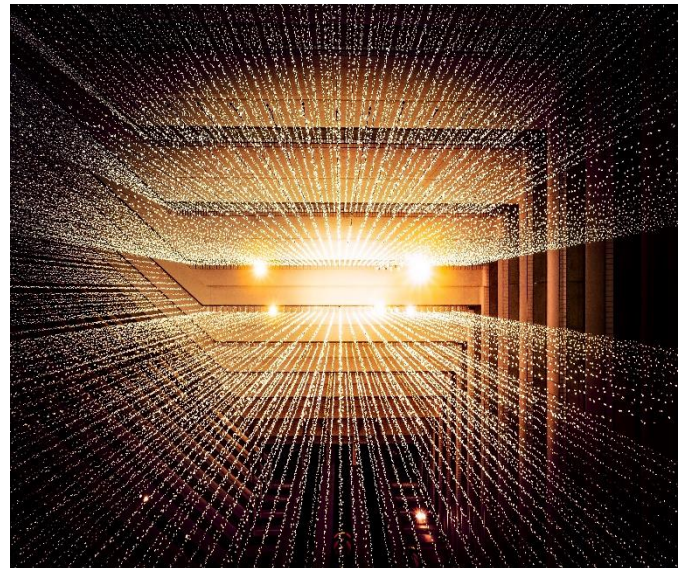
【Technical】芯測推出車電專用解決方案

近來，全球晶片短缺，衝擊車用晶片市場，也帶動半導體相關廠商的產能需求大增，從 IC 設計、晶圓、記憶體、封測等產業也受惠。目前全球汽車大廠爭相投入的研發方向多以如何生產更安全、舒適、方便的高科技車輛為主要目標。

[Read More +](#)

【Technical】記憶體測試向量自動轉換與記憶體測試後診斷分析自動轉換微架構

隨著人工智慧、邊緣運算、物聯網與 AIoT 的應用越來越廣泛，市場對於晶片的需求就越大。這些晶片都需要使用 SRAM (Static Random Access Memory)，作為驅動晶片運行的主要程式儲存的地方，如何精準找出 SRAM 的缺陷，並且節省晶片測試成本相當重要。所以，如何選用兼具測試精準度與降低測試成本的記憶體測試演算法，一直是晶片製造商關注的問題。

[Read More +](#)

【Technical】還在為選擇記憶體測試演算法而煩惱嗎？



隨著先進製程的應用越來越廣泛，物聯網(IoT, Internet of Things)晶片、高效能運算(HPC, High Performance Computing)晶片、人工智慧(AI, Artificial Intelligence)晶片、邊緣運算(Edge computing)晶片與影像處理(ISP, Image Signal Processing)晶片等，都需要使用更先進製程。在先進製程與上述各類應用需求的提升下，使用 SRAM (SRAM, Static Random Access Memory) 來儲存複雜的程式的情況越來越多。如何精準找出記憶體缺陷，降低 DPPM(DPPM, Defect Parts Per Million)相當重要。

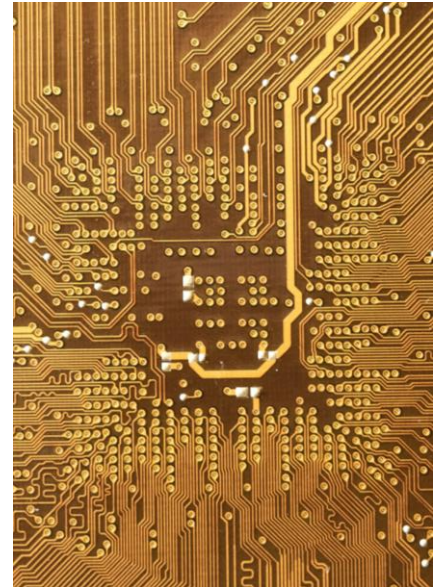
[Read More +](#)

► 新聞 | News

【News】殺手級應用 EZ-BIST+UDA 助晶片開發商掌控晶片良率

目前，微控制器(MCU, Micro Controller Unit)相關晶片，包括：無線網路(Wi-Fi)晶片、低功耗藍芽(BLE, Bluetooth Low Energy)傳輸晶片、觸控與指紋辨識晶片與智慧音訊相關晶片等。

芯測科技分析，上述晶片都採用 32 位元的中央處理器(CPU, Central Processing Unit)執行儲存在『記憶體』內的通訊協議或是各類的演算法。這時晶片中的靜態隨機存取記憶體(SRAM, Static Random Access Memory)的需求也將大幅提升，因為這類晶片都需要使用 SRAM，作為驅動晶片運行的主要程式儲存的地方，如何精準找出 SRAM 的缺陷，以及如何降低每百萬個產品中的不良數(DPPM, Defect Parts Per Million)成為了各家 IC 設計公司與晶片開發商專注的重點。

[Read More +](#)

【News】芯測科傳佳音 成功推出 UDA GUI-Based 微架構

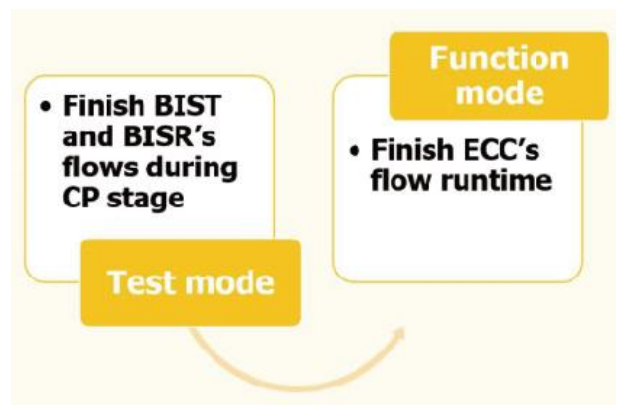
隨著先進製程應用廣泛，不論是高效能運算晶片、人工智慧晶片、邊緣運算晶片與影像處理晶片，都需使用先進製程。

其中，芯測科技點出，記憶體的使用在先進製程下，因為中央處理器 (CPU, Central Processing Unit) 執行連續讀寫的操作或是連續讀寫後加上一個常數值的操作行為，而產生動態失效 (Dynamic fault)，必須採用複雜度更高的記憶體測試演算法，例如 March MD2，才能檢測出動態失效的情況。

[Read More +](#)

【News】進軍車用商機 芯測推出車電專用解決方案

近來，全球晶片短缺，衝擊車用晶片市場，也帶動半導體相關廠商的產能需求大增。芯測科技指出，目前全球汽車大廠爭相投入的研發方向，多以如何生產更安全、舒適、方便的高科技車輛為主要目標。

[Read More +](#)

▶ 線上研討會 | Webinar



iSTART | Webinar

還在為如何選擇
記憶體測試演算法
而煩惱嗎?

Date **2022 / 3 / 24**
14:00

Speaker **TP Hsieh**
芯測科技技術服務部
資深技術經理

Register now

[Read More +](#)**【Webinar】**還在為如何選擇記憶體測試演算法而煩惱嗎?

隨著先進製程的應用越來越廣泛，舉凡高效能運算 (HPC, High Performance Computing) 晶片、人工智慧晶片、邊緣運算晶片與影像處理晶片等，都需要使用先進製程。但是，記憶體的使用在先進製程下，產生動態失效 (Dynamic fault) 的機率增加。